

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專訴字第20號

原告 陳松德
訴訟代理人 陳韻如律師
複代理人 江玟萱律師
輔佐人 黃富源
被告 國聯窯業股份有限公司
法定代理人 林義仁
輔佐人 廖銘吉
被告 智陞建材有限公司
法定代理人 劉文智
共同
訴訟代理人 蘇佑倫律師
王蕙瑄律師
童啟哲

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國112年12月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案件審理法修正施行前即111年12月12日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（見本院卷一第13頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一、不甚礙被告防禦及訴訟之終結者，不在此

限，民事訴訟法第255條第1項但書第2款、第7款定有明文。又按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，同法第262條第1項亦有明文。查本件原告起訴時，原聲明請求：「(一)被告應給付原告新臺幣（下同）100萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(二)被告不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣原告所有之中華民國新型專利第M608457號「具識別之樓梯磚結構」專利（下稱系爭專利）之產品。(三)被告已流通至市面之前項聲明產品，並應予回收並銷燬。(四)第1項及第2項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。」（見本院卷一第13頁），嗣於112年4月7日具狀變更第一項聲明：「(一)被告應連帶給付原告100萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。」（見本院卷一第181頁），復於本院112年8月29日準備程序中，以言詞撤回就第二項聲明之假執行聲請（見本院卷一第300頁），核其所為，係本於被告侵害原告專利權之同一基礎事實，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，於法核無不合，應予准許；又原告係於本件訴訟言詞辯論前撤回就第二項聲明之假執行聲請，揆諸前揭規定，無庸得被告同意而生效力，併此說明。

三、按當事人法定代理人之代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人承受其訴訟以前當然停止，民事訴訟法第170條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受訴訟，民事訴訟法第170條、第175條分別明文規定。查被告國聯窯業股份有限公司（下稱國聯公司）之法定代理人原為林茂松，嗣於訴訟進行中變更為林義仁，有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可稽（見本院卷一第173頁、第273頁），並經被告國聯公司於112年3月10日具狀聲明承受訴訟（見本院卷一第166頁），核符規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

01 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自110年3月1日起
02 至120年9月28日止。原告於111年7月1日委由第三人龍泰磁
03 磚有限公司於鶯發建材行購買被告國聯公司生產製造及由被
04 告智陞建材有限公司（下稱智陞公司）為代理銷售之200*27
05 0mm金櫻樓梯石英磚（下稱系爭產品）後，將其送請中正專
06 利商標聯合事務所進行專利侵權分析比對，認系爭產品落入
07 系爭專利之申請專利範圍，原告即於111年8月9日委請事務
08 所寄發存證信函通知被告2公司系爭產品侵害系爭專利之專
09 利權，並請求排除侵害及賠償損害，惟被告2公司於111年8
10 月12日收受該信函後迄今仍繼續販賣系爭產品，故有侵害系
11 爭專利之故意，而致原告受有損害。又原告就系爭產品請上
12 開事務所為專利分析比對之進一步說明，經該事務所於112
13 年3月30日出具鑑定報告，認系爭產品落入更正後系爭專利
14 請求項1、2、7、8、9、12之文義範圍，再系爭產品與更正
15 後系爭專利請求項1在方法、功能及結果上仍均屬相同，系
16 爭產品亦落入系爭專利請求項1之均等範圍。爰依專利法第1
17 20條準用第96條第2項規定、民法第185條第1項，請求被告2
18 公司連帶給付100萬元損害賠償；復依專利法第120條準用第
19 96條第1、3項，請求被告2公司防止、排除侵害。

20 (二)並聲明：

- 21 1.被告應連帶給付原告100萬元，及自起訴狀送達翌日起至清
22 償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
- 23 2.被告不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要
24 約、販賣原告所有系爭專利之產品。
- 25 3.被告已流通至市面之前項聲明產品，並應予回收並銷燬。
- 26 4.第一項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

27 二、被告則以：

28 (一)系爭產品所涉一體成型樓梯磚結構為習知技術，為二層結
29 構，因配合建築物無障礙設施設計規範第304.3條規定要
30 求，方以噴墨機噴塗墨水方式將系爭產品凸出層染色，實無
31 再作一層之止滑層，並經被告將實施系爭專利之龍泰磁磚有

01 限公司KEDA雙色識別樓梯磚產品（下稱龍泰KEDA磁磚）與系
02 爭產品送請台灣檢驗科技股份有限公司鑑定防滑係數，經該
03 公司所鑑定結果認系爭產品於水平及垂直方向之防滑係數均
04 低於內政部發佈之建築物地坪面磚防滑係數或等級指導原則
05 及龍泰KEDA磁磚鑑定結果，及依原告提出之系爭產品放大20
06 0倍照片，未見有何三層結構，益徵系爭產品無施作止滑
07 層，而系爭產品防滑效果係利用業界習見方法，以模具將磁
08 磚前段壓製數個凸起條或凹陷條達到，與系爭專利為凸出
09 層、識別層、止滑層之三層結構明顯不同，無任何元件或特
10 徵可對應系爭專利之止滑層，是系爭產品並未落入系爭專利
11 請求項1、2、7、8、9、12之文義範圍，不符合文義讀取，
12 且於方法、功能或結果上與前揭請求項不同，亦不符合均等
13 論，故系爭產品未侵害系爭專利。況系爭專利請求項1因申
14 請歷史禁反言原則，應不適用均等論。

15 (二)並聲明：

16 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

17 2.訴訟費用由原告負擔。

18 3.如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

19 三、本院整理並補充兩造不爭執事項（見本院卷一第302頁、第3
20 92頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論述順序整
21 理內容）：

22 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自110年3月1日起
23 至120年9月28日止。

24 (二)原告就系爭專利於110年12月10日向經濟部智慧財產局（下
25 稱智慧局）申請更正，經智慧局審定准予更正，並於111年3
26 月21日公告在案。

27 (三)系爭產品為被告國聯公司生產製造、銷售，並由被告智陞公
28 司為總代理銷售。原告於111年8月9日委請事務所寄發存證
29 信函通知被告2公司，被告國聯公司於111年8月12日委請律
30 師發函回覆原告。

31 四、得心證之理由：

原告主張其為系爭專利之專利權人，現仍於專利權期間內，被告國聯公司生產製造及由被告智陞公司為代理銷售之系爭產品落入更正後系爭專利請求項1、2、7、8、9、12之文義範圍，及落入更正後系爭專利請求項1之均等範圍，而侵害原告就系爭專利之專利權等情，為被告所否認，並以前詞置辯。經查：

(一)系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術內容：

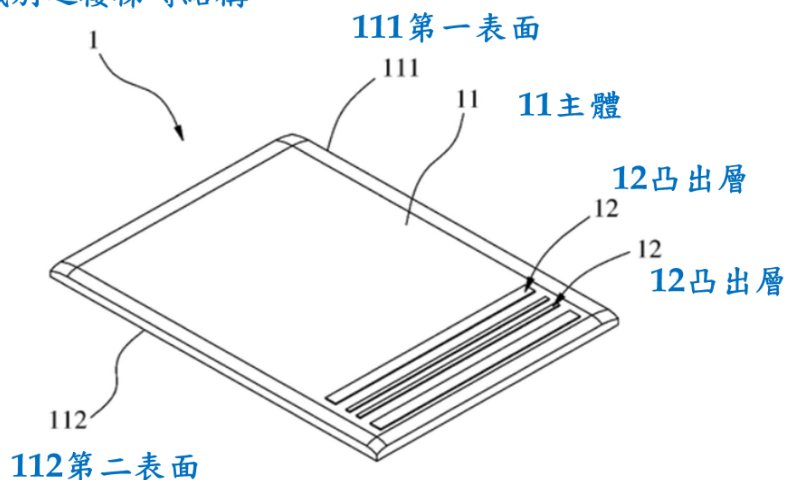
依系爭專利說明書第【0004】、【0016】段所載（見本院卷一第198頁、第199頁），系爭專利提出之一種具識別之樓梯磚結構，係設置於一樓梯之台階上，具識別之樓梯磚結構係至少包括有一主體、至少一凸出層，以及至少一識別層；主體係包括有一第一表面；至少一凸出層係設置於主體之第一表面上；至少一識別層係對應主體而設置於凸出層之另一端面。系爭專利具識別之樓梯磚結構主要係藉由在每一階樓梯的前緣以與樓梯主體一體成形之方式設置凸出態樣之凸出層與識別層之硬體設計，有效減少傳統樓梯所設置之止滑條因二次加工而造成製造時間與製造成本增加之問題，亦可有效解決傳統止滑條不易在昏暗的空間中被使用者察覺之缺點，確實達到提供使用者明確識別樓梯之台階位置，以及減少施工時間與製造成本等主要優勢。

2.系爭專利主要圖式（見本院卷一第207頁、第208頁、第210頁、第213頁，藍色文字及數字為本判決增加之說明）：

(1)其一較佳實施例之整體結構立體圖：

01

1具識別之樓梯磚結構

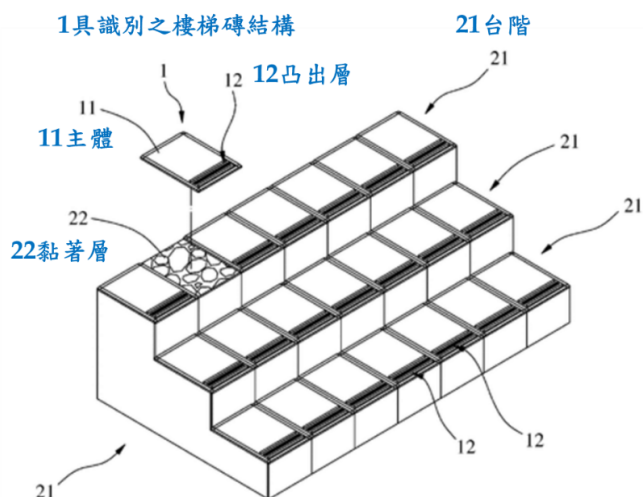


02

(2)其一較佳實施例之樓梯台階鋪設示意圖：

03

04



05

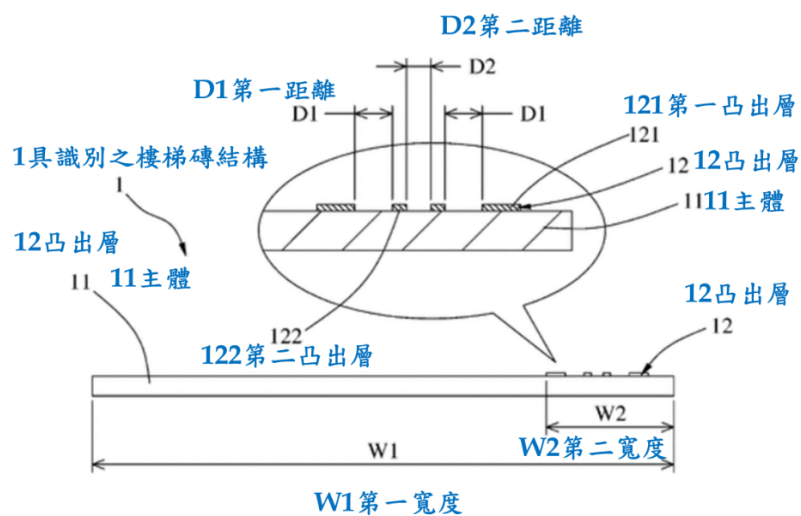
第 2 圖

06

(3)其二較佳實施例之凸出層設置示意圖：

07

08



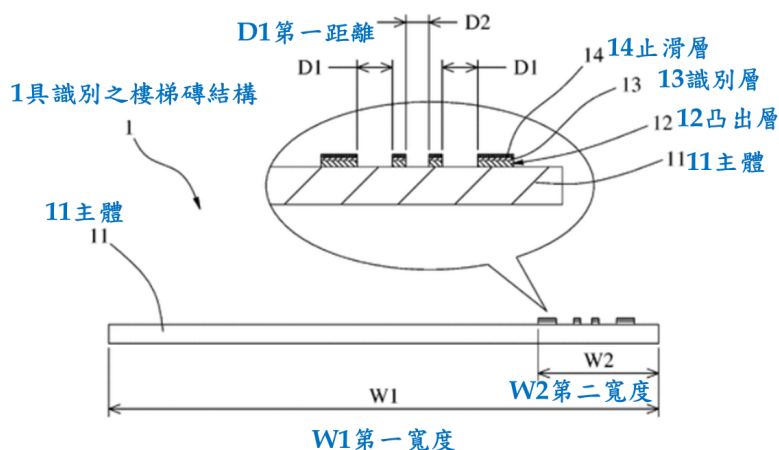
09

10

第 4 圖

11

(4)其五較佳實施例之止滑層設置示意圖：



第 7 圖

3.系爭專利申請專利範圍及解釋：

(1)系爭專利原經智慧局核准公告之申請專利範圍共計12項，其中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項。原告於110年12月10日向智慧局申請更正申請專利範圍，而經智慧局於111年3月21日核准更正及公告，更正後刪除原請求項3至6、10、11，請求項1後段增加「其中該主體係具有一第一寬度，而該凸出層係具有一第二寬度，其中該第一寬度與該第二寬度之比值係介於3：1至7：1之間；其中該識別層係以印刷或塗佈其中之一方式形成於該凸出層上，該識別層相對於該凸出層之另一端面係進一步形成有一止滑層」，本件原告主張受侵害者為更正後系爭專利請求項1、2、7、8、9、12，故就前開更正後請求項內容分述如下：

①請求項1：

一種具識別之樓梯磚結構，係設置於一樓梯之一台階上，該具識別之樓梯磚結構係至少包括有：一主體，係包括有一第一表面；至少一凸出層，係設置於該主體之該第一表面上；以及至少一識別層，係對應該主體而設置於該凸出層之另一端面；其中該凸出層係與該主體一體成形；其中該凸出層係靠近該主體之一端部設置；其中該主體係具有一第一寬度，而該凸出層係具有一第二寬度，其中該第一寬度與該第二寬

01 度之比值係介於3：1至7：1之間；其中該識別層係以印刷或
02 塗佈其中之一方式形成於該凸出層上，該識別層相對於該凸
03 出層之另一端面係進一步形成有一止滑層。

04 ②請求項2：

05 如請求項1所述之具識別之樓梯磚結構，其中該主體係進一
06 步包括有一與該第一表面相對設置之第二表面，而該第二表
07 面係藉由一黏著層貼附於該樓梯之該台階上。

08 ③請求項7：

09 如請求項1所述之具識別之樓梯磚結構，其中該凸出層係進
10 一步包括有複數個第一凸出層，以及複數個第二凸出層。

11 ④請求項8：

12 如請求項7所述之具識別之樓梯磚結構，其中該第一凸出層
13 與該第一凸出層之間係具有一第一距離，且該第一凸出層與
14 該第二凸出層之間係具有該第一距離。

15 ⑤請求項9：

16 如請求項7所述之具識別之樓梯磚結構，其中該第二凸出層
17 與該第二凸出層之間係具有一第二距離。

18 ⑥請求項12：

19 如請求項1所述之具識別之樓梯磚結構，其中該止滑層相對
20 於該識別層之另一端面係為一粗糙面。

21 (二)系爭產品技術內容：

22 1.依本院112年12月26日當庭勘驗經原告切割後之系爭產品結
23 果及勘驗照片（見本院卷二第202頁、附表二編號1），系爭
24 產品之磁磚表面同一側，有四條深咖啡色長方形凸起條，其
25 中三條寬度均為0.7公分，彼此間間距為0.3公分，一條為1.
26 2公分，與最近寬度0.7公分突起條間距為1公分；經切割之
27 側邊截面，除與凸起條頂面連接部分有極細之深咖啡色邊
28 外，其餘均為磁磚本身之顏色。

29 2.系爭產品實物照片：如附表二各編號所示。

30 (三)更正後系爭專利請求項1、2、7、8、9、12與系爭產品之文
31 義比對分析：

01 1.查專利侵權分析應用全要件原則，須先解析系爭專利請求項
02 及被控侵權物以確認其等技術特徵，則關於系爭專利請求項
03 1及系爭產品，解析其等技術特徵如附表一所示要件。以下
04 判斷系爭產品是否落入更正後系爭專利請求項1之文義範
05 圍。

06 (1)系爭專利請求項1要件編號1A：

07 查依系爭產品實物照片（如附表二所示），系爭產品為一種
08 磁磚結構，雖可對應於系爭專利請求項1要件編號1A「一種
09 具識別之樓梯磚結構」之技術內容，惟因系爭產品之磁磚結
10 構為單體之磁磚，且經原告於本院審理時陳稱：系爭產品於
11 銷售時，均以一箱一箱包裝方式販賣，而無其他銷售態樣及
12 方式等語（見本院卷一第301頁），此有系爭產品以箱裝販
13 售之實物照片在卷可參（見本院卷一第27頁），併參酌兩造
14 所提之專利侵害鑑定報告或不侵權分析答辯等內容（見本院
15 卷一第91頁至第105頁、第217頁至第248頁、第360頁至第36
16 4頁），均係就系爭產品以單體磁磚之形式而為鑑定、分
17 析，並未將之設置於一樓梯之一台階上，即與系爭專利請求
18 項1要件編號1A所界定「設置於一樓梯之一台階上」之技術
19 特徵並不相同。因此，系爭產品無法為系爭專利請求項1要
20 件編號1A所文義讀取。

21 (2)系爭專利請求項1要件編號1B至1G：

22 依原告所提專利侵害鑑定報告、本院112年12月26日當庭勘
23 驗經原告切割後之系爭產品結果及勘驗照片、系爭產品實物
24 照片（見本院卷一第217頁至第248頁、本院卷二第202頁、
25 附表二所示），可知系爭產品之一主體，係包括有一第一表
26 面；至少一凸出層，係設置於該主體之該第一表面上；以及
27 至少一粗糙之釉料層，係對應該磁磚本體而設置於該凸出層
28 之上面；其中該凸出層係與該主體一體成形；其中該凸出層
29 係靠近該主體之一端部設置；其中該磁磚本體係具有一第一
30 寬度，而該凸出層係具有一第二寬度，其中該第一寬度與該
31 第二寬度之比值約27.5：5.5（即5：1），分別完全對應於

系爭專利請求項1要件編號1B至1G各揭示「一主體，係包括有一第一表面」、「至少一凸出層，係設置於該主體之該第一表面上」、「以及至少一識別層，係對應該主體而設置於該凸出層之另一端面」、「其中該凸出層係與該主體一體成形」、「其中該凸出層係靠近該主體之一端部設置」、「其中該主體係具有一第一寬度，而該凸出層係具有一第二寬度，其中該第一寬度與該第二寬度之比值係介於3：1至7：1之間」之技術特徵，是系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1B至1G所文義讀取。

(3)系爭專利請求項1要件編號1H：

查依系爭產品實物照片（如附表二所示），系爭產品於凸出層上雖有粗糙之釉料層，且該釉料層係以印刷形成於該凸出層上，而可對應於系爭專利請求項1要件編號1H「其中該識別層係以印刷或塗佈其中之一方式形成於該凸出層上」之技術特徵；然依本院112年12月26日當庭勘驗經原告切割後之系爭產品結果及勘驗照片（見本院卷二第202頁、附表二編號1），系爭產品經切割之側邊截面，除與凸起條頂面連接部分有極細之深咖啡色邊外，其餘均為磁磚本身之顏色，又參以前揭系爭專利主要圖式(4)，該止滑層為獨立於識別層上，可知系爭產品上粗糙之釉料層相對於該凸出層之另一端面無任何膜層，而欠缺系爭專利所揭示「止滑層」之結構，故系爭產品即無法對應於系爭專利請求項1要件編號1H「該識別層相對於該凸出層之另一端面係進一步形成有一止滑層」之技術特徵，自無法為系爭專利請求項1要件編號1H所文義讀取。

(4)綜上所述，系爭產品無法為更正後系爭專利請求項1要件編號1A、1H所文義讀取，基於全要件原則，系爭產品未落入更正後系爭專利請求項1之文義範圍。

2.更正後系爭專利請求項2、7、8、9、12均為直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含更正後系爭專利請求項1之全部技術特徵。系爭產品既未落入更正後系爭專利請求項1之文義

01 範圍，業經本院認定如前，則系爭產品自無落入更正後系爭
02 專利請求項2、7、8、9、12之文義範圍，以下續為均等論分
03 析。

04 (四)系爭專利請求項1與系爭產品之均等比對分析：

05 判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵
06 權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比
07 對。專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權
08 時，被控侵權人得提出抗辯，主張全要件原則、申請歷史禁
09 反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項以限制均等論，若任
10 一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不
11 構成均等侵權。又由於文字之敘述有其侷限性，且無法合理
12 期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同
13 的技術特徵完全寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷
14 限於文義範圍，而應另外包含均等範圍，此乃均等論之意
15 旨。然而，對於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過
16 程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，則難
17 謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄（surr
18 ender）部分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而
19 重為主張其已放棄之專利，則此非但不符合均等論之意旨，
20 且將增加專利權申請範圍之不確定性。就系爭產品是否落入
21 系爭專利要件編號1H均等範圍，原告主張：縱將更正後系爭
22 專利請求項1要件編號1H解讀為依序堆疊凸起層、識別層、
23 止滑層之三層結構，然因作為識別層之釉料層之下層具有顏
24 色，表層具多個顆粒而產生止滑效果，是止滑層與釉料表面
25 之止滑面為類似手段，產生相同之功能與結果云云，然依系
26 爭專利公告本內容（見本院卷一第193頁至第215頁），原告
27 既已將更正後請求項1增加「其中該主體係具有一第一寬
28 度，而該凸出層係具有一第二寬度，其中該第一寬度與該第
29 二寬度之比值係介於3：1至7：1之間；其中該識別層係以印
30 刷或塗佈其中之一方式形成於該凸出層上，該識別層相對於
31 該凸出層之另一端面係進一步形成有一止滑層」之技術特

徵，業如前述，且依其於111年1月15日因應智慧局之審查意見及所用之先前技術即引證案所提出申復理由書（見本院卷二第43頁至第59頁），其中文獻1所載技術特徵及相關圖式（見本院卷二第50頁至第51頁），可知文獻1之砂輪條3應可對應於系爭專利請求項1之識別層，且已揭示該技術藉由砂輪條表面達到防滑之效果；其中文獻3所載技術特徵及相關圖式（見本院卷二第53頁至第56頁），亦知文獻3所載防滑紋理7包括若干個波紋棱組，每個波紋棱組包括若干個波紋棱7a，波紋棱的設置能夠在於波紋棱的長度方向垂直的方向上起到有效的防滑功能，且依圖式所載，該技術所揭露之具止滑效果之波紋棱可對應於系爭專利請求項1之識別層，而原告為主張系爭專利請求項1相較於智慧局所用先前技術即文獻1、3係具有進步性之專利要件，即於申復過程中更正請求項1如前，並認文獻1之砂輪層表面、文獻3之波紋棱均未揭露更正後請求項1所增之「識別層相對於凸出層之另一端面進一步形成有止滑層」技術內容。是原告為維護專利權與文獻1、3之先前技術所載砂輪條表面、波紋棱作為區隔，因而將系爭專利請求項1更正即增加關於止滑層之技術特徵，實已限縮系爭專利請求項1之申請專利範圍，原告自不得於本件專利訴訟中再藉由均等論而主張擴張識別層（即釉料層）表面與止滑層實質相同。基此，原告此部分主張違反申請歷史禁反言，並無足取。

- (五)原告雖主張：系爭產品之釉料係位於凸出層向上的一端面，且具一定之厚度，而系爭產品釉料經過燒結後，釉料表面以下之部分依舊保有釉料顏色，而可作為識別層，其釉料表面（或釉料表層）經燒結後所形成多個粗大的顆粒，使釉料表面上端面產生粗糙度，因而使釉料表面形成止滑層，故符合系爭專利所揭示「該識別層相對於該凸出層之另一端面係進一步形成有一止滑層」之技術特徵，或與該技術特徵無實質差異云云。惟依系爭專利說明書第【0014】、【0015】、【0025】段所載「在本創作的一個實施例中，識別層相對於

凸出層之另一端面係可進一步形成有一止滑層。在本創作的一個實施例中，止滑層相對於識別層之另一端面係為一粗糙面。」、「再者，請一併參閱第7圖所示，為本創作具識別之樓梯磚結構其五較佳實施例之止滑層設置示意圖，其中該識別層相對於該凸出層之另一端面係形成有一止滑層，且該止滑層相對於該識別層之另一端面係為一粗糙面，該止滑層之粗糙面係有止滑之效果，以防止上下該樓梯之使用者發生滑倒之憾事。」等語（見本院卷一第199頁、第202頁），可知系爭專利之止滑層係進一步形成於識別層相對於凸出層之另一端面，而與識別層非同一，兩者結構亦不相同；且參酌前揭系爭專利主要圖式(4)所示，系爭產品之凸出層、識別層、止滑層為三層可分之結構。再者，系爭產品上粗糙之釉料層係經被告透過印刷噴塗、燒結所形成之事實，為兩造所不爭執，益徵系爭產品上粗糙之釉料層是一次形成之一膜層，且依本院112年12月26日當庭勘驗經原告切割後之系爭產品結果及勘驗照片（見本院卷二第202頁、附表二編號1），系爭產品之凸出層上粗糙之釉料層係存於在凸起之表層，且該釉料層為單一顏色即深咖啡色，而無任何界面，可知該粗糙屬一次形成之單一膜層，並非先形成釉料下層後，再於該釉料下層相對於該凸出層之另一端面係進一步形成有一釉料上層。此外，原告亦無提出該釉料層為上、下兩層、釉料層表面經燒結所產生粗糙度即屬系爭專利所稱止滑層之相關證據為佐，自無從僅憑上開主張而認該釉料層得對應於系爭專利之識別層、止滑層之事實。是依卷證資料，系爭產品僅有粗糙之釉料層係以印刷形成於該凸出層上，與系爭專利凸出層、識別層、止滑層為三層結構顯不相當，原告上開主張，自無可採。

(六)查系爭產品並未落入原告主張更正後系爭專利請求項1、2、7、8、9、12文義範圍，亦未落入系爭專利請求項1之均等範圍，業經本院認定如前，是原告據此主張被告國聯公司生產製造、銷售及由被告智陞公司總代理銷售之系爭產品，侵害

原告就系爭專利之專利權，並致其受有損害乙節，即非有據。至本件其餘爭點，則均無論駁之必要，併此敘明。

五、從而，原告依專利法第120條準用第96條第1項至第3項規定、民法第185條第1項，請求被告排除、防止侵害及連帶給付100萬元損害賠償本息，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應一併駁回。

六、至原告請求鑑定系爭產品之凸出層相對於磁磚本體正面是否較為粗糙而有止滑效果等情，惟原告既未能證明系爭產品具有系爭專利所揭露之凸出層、識別層、止滑層之三層結構，且其所提出之內政部建築研究報告之節錄內容（見本院卷二第19頁至第21頁），並非針對磁磚止滑效果之研究，亦非屬國家標準檢驗磁磚止滑效果之方式，則其聲請量測系爭產品動摩擦係數，實無調查之依據與必要。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告既不得以系爭產品侵害系爭專利權而請求被告排除、防止侵害與賠償損害，本件即無為中間判決之必要，爰為終局判決，末此敘明。

七、結論：本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 1 月 23 日

智慧財產第三庭

法 官 潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 113 年 1 月 24 日

書記官 李建毅

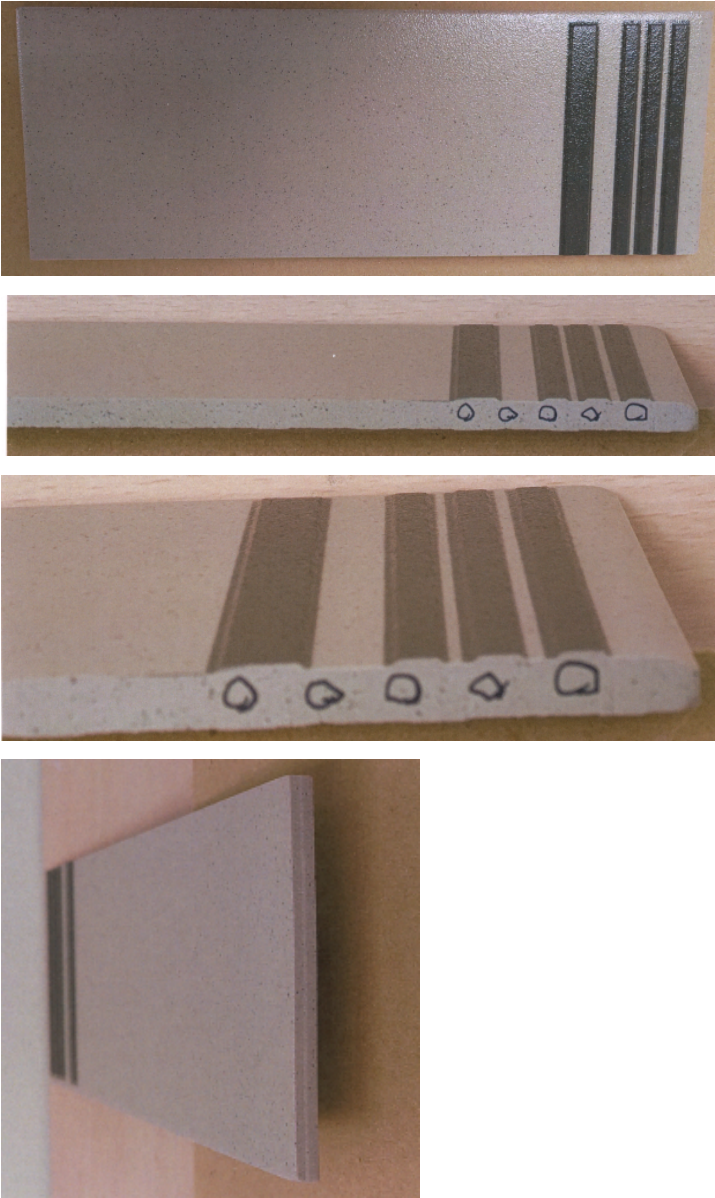
附表一：

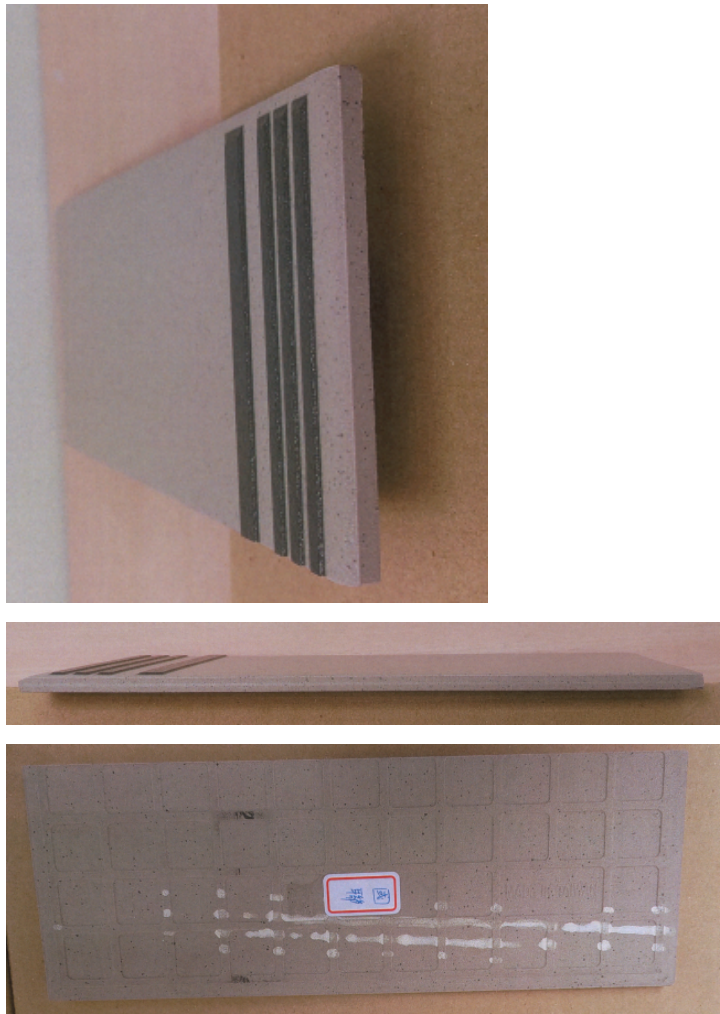
要件 編號	系爭專利 請求項1	要件 編號	系爭產品 技術內容

1A	一種具識別之樓梯磚結構，係設置於一樓梯（2）之一台階（21）上，該具識別之樓梯磚結構（1）係至少包括有：	1a	一種磁磚結構，
1B	一主體（11），係包括有一第一表面（111）；	1b	一主體，係包括有一第一表面；
1C	至少一凸出層（12），係設置於該主體（11）之該第一表面（111）上；	1c	至少一凸出層，係設置於該主體之該第一表面上；
1D	以及至少一識別層（13），係對應該主體（11）而設置於該凸出層（12）之另一端面；	1d	以及至少一粗糙之釉料層，係對應該磁磚本體而設置於該凸出層之上面；
1E	其中該凸出層（12）係與該主體（11）一體成形；	1e	其中該凸出層係與該主體一體成形；
1F	其中該凸出層（12）係靠近該主體（11）之一端部設置；	1f	其中該凸出層係靠近該主體之一端部設置；
1G	其中該主體（11）係具有一第一寬度（W1），而該凸出層（12）係具有一第二寬度（W2），其中該第一寬度（W1）與該第二寬度（W2）之比值係介於3：1至7：1之間；	1g	其中該磁磚本體係具有一第一寬度，而該凸出層係具有一第二寬度，其中該第一寬度與該第二寬度之比值約2.75:5.5；
1H	其中該識別層（13）係以印刷或塗佈其中之一方式形成於該凸出層（12）上，該識別層（13）相對於該凸出層（12）之另一	1h	其中該粗糙之釉料層係以印刷形成於該凸出層上，該粗糙之釉料層相對於該凸出層之另一端面無任何膜層。

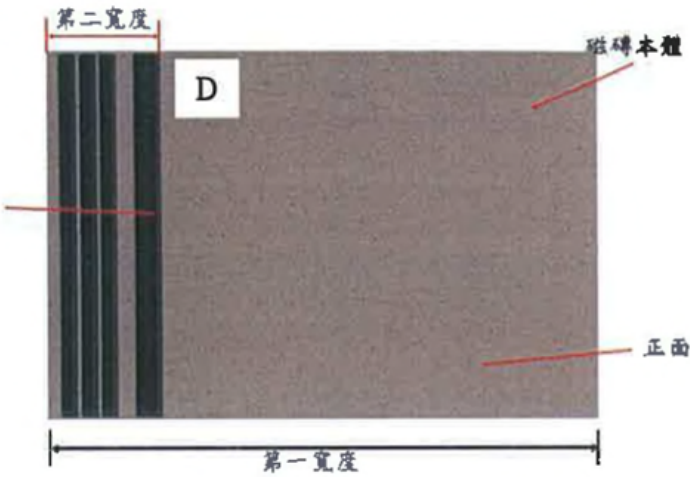
01	端面係進一步形成有一止滑層（14）。		
----	--------------------	--	--

02 附表二：
03

編號	系爭產品照片	卷證出處
1		本院卷二第205頁至第217頁



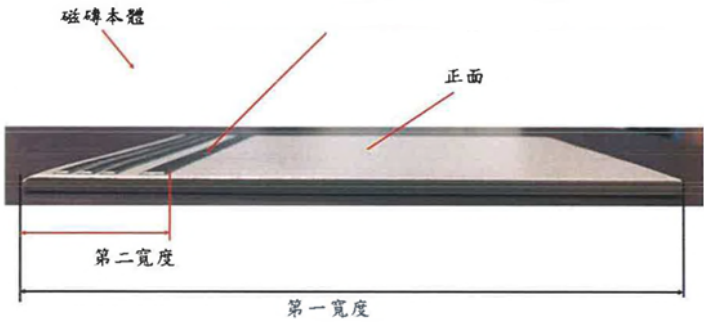
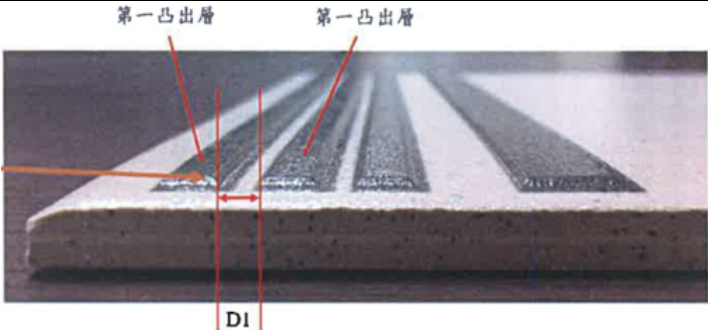
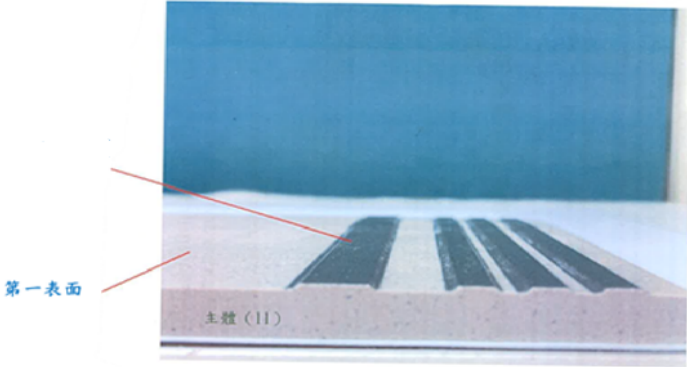
2



本院卷一第231頁

3

本院卷一第226頁

	 磁帶本體 正面 第二寬度 第一寬度	
4	 第一凸出層 第一凸出層 D1	本院卷一第241頁
5	 第一表面 主體 (II)	本院卷一第347頁